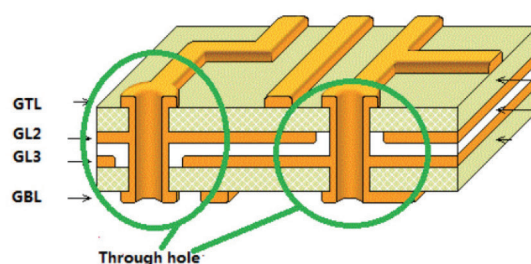
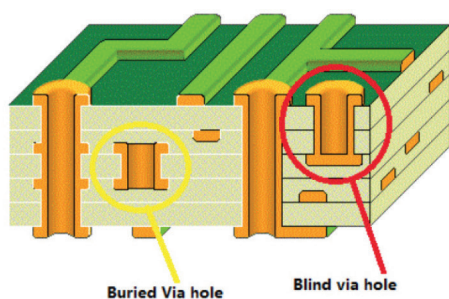


TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN VON PCB

ATTRIBUT	KAPAZITÄT
Produkte	ES - Einseitige Leiterplatten DS - Doppelseitige Leiterplatten ML - Multilayer (mehrschichtige Leiterplatten)
Basismaterialien	FR4, CEM1, IMS (Al), IMS (Cu) PTFE, RF IZOKART (Pertinaks), VITROPLAST
Hersteller von Basismaterialien	Kingboard, Nanya, Isola, Rogers, Bergquist, ...
Thermische Stabilität	TG130 - TG210
Wärmeleitfähigkeit IMS	0,3 W/m°C 2,0 W/m°C (standard) 5,0 W/m°C
Maximalformat	500 x 600 mm
Dicke der Platte (Ende)	0,2 mm - 3,2 mm
Dicke der Zwischenschichten	0,08 mm - 3,2 mm
Mindestbindungs- und Isolationsbreite	70 µm (70 µm)
Dicke der Basiskupferfolie	18 µm, 35 µm, 70 µm, 105 µm
Dicke der Kupferbasisfolie auf Zwischenschichten	18 µm, 35 µm, 70 µm, 105 µm
Durchmesser der kleinsten Bohrung ohne Bohrung	0,15 mm
Arten von Löchern	Durchgangslöcher - Through hole Sackloch - Blind via hole Buried Löcher - Buried via hole Bohrlöcher - Half holes



*Vedno korak naprej.
Always a step further.*

Blindbohrungen (Verhältnis der Durchmesser-Tiefe)	1 : 1
Lötdeckung	Grün: matt, glänzend Schwarz Weiß Blau Rot Gelb
Auflösung der Lötdeckung	70 µm
Farbe des Fertigblechs	Weiß Grün Gelb Schwarz Rot Blau
Versenkbare Abdeckung	EM55/4748 R-LF (Electra Polymer)
Kreuzungen abdecken	Mit Lötdeckung abgedeckt
Gefüllte Eingänge	Mit nicht leitfähiger Paste, gemäß IPC-4761 - 6a + 6b + 7
Oberflächenschutz	HAL ohne Blei (RoHS) Chemisches Au (ENIG) Galvanisches Au (Hartgold)
Mechanische Toleranzen	Für das allgemeine Bohren und Fräsen verwenden wir allgemeine Toleranzen nach DIN ISO 2768 T1
Endproduktstärke	+/-10 %
Ätzen Toleranz	+/-20 % (+/-10%)

